

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	长城基金、汐泰投资、宝盈基金、金鹰基金、易方达基金、信达澳亚、博时基金、招商基金、平安基金、南方基金、国投瑞银、诺安基金、鹏华基金、景顺长城基金、中邮证券、招商证券、华西证券、大摩基金、创金合信、盘京投资、华夏基金、中欧基金、浙商证券、华商基金、华源证券、东北证券、国联民生证券、正圆投资、华福证券、和谐江一、广发证券
时间	2026年1月5日-2026年1月14日
地点	广州、深圳、成都、公司和线上
上市公司 接待人员姓名	总经理：向文胜 常务副总经理、董事会秘书：陈小华 合规总监：李瑞媛 证券事务代表：徐雯
投资者关系活动主 要内容介绍	问题一：公司光刻胶推进情况？ 答：先进封装是公司光刻胶产品布局最重点应用领域，围绕 RDL, Bumping, fine pitch RDL、TSV 等核心工艺，公司已形成近 10 款光刻胶产品矩阵，实现先进封装全场景覆盖，成为国内少数具备“全品类供应

能力”的本土供应商。其中 Bumping 负性光刻胶已成功替代日本 JSR，在国内头部封装厂实现批量稳定供应，公司是目前唯一实现该品类国产化替代的供应商，市场份额持续提升；PSPI 光刻胶在客户端验证进展顺利。在晶圆制造领域，公司聚焦 IGBT 和 Memory 等特色应用，重点布局 PSPI 光刻胶、化学放大型光刻胶以及 KrF 光刻胶，其中正性 PSPI 已在头部客户实现稳定量产，超高感度 PSPI 和低温固化负性 PSPI 等产品处于客户端验证阶段，以适配不同技术需求。

问题二：目前公司基本面的景气度。

答：公司定位于“电镀+光刻”双核心工艺平台，并深度卡位先进封装、晶圆制造先进节点等高增长赛道，已成长为半导体市场高景气度的核心受益者与有力参与者。除行业整体景气度提升外，国产化率提升和产品渗透率提高，推动公司业务的增长。

问题三：展望今年公司的核心增长机遇？

答：公司与国内核心客户的合作，目前已迈向更深层次的战略协同，公司角色已从“国产替代、响应客户需求、保障稳定供应”，逐步演进为深度参与客户新产品的早期研发与测试，从而实现材料方案的超前研发与匹配。公司通过联合实验室、先导性测试项目等方式，与头部客户共同推进多项半导体材料验证与导入，一方面，巩固供应链地位，配合国内先进封装和先进制程技术的快速进步与产品量产节奏，另一方面，能够更早感知终端应用（如 AI、高性能计算）的技术迭代方向与半导体工艺的创新路径，从而实现材料方案的前瞻性研发与精准匹配，抓住行业高景气机遇。

问题四：目前芯片制程不断下探，公司产品有什么优势？

答：随着芯片制程向更先进节点推进，公司大马士革电镀产品适配先进节点，已实现从先导验证到量产的全线覆盖。另外存储技术的迭代，垂直通孔（TSV）与铜柱互连工艺对高深宽比电镀均匀性提出严苛要求，形成对高性能电镀液与高分辨率光刻胶的刚性需求，公司产品性能满足上述要求。

问题五：公司客户目前推动国产化的意愿如何？

答：复杂的地缘政治背景将刺激客户对供应链安全的高度警觉，客

	户推动国产化的意愿呈现出显著增强态势，并且国产化意愿已从政策驱动型转向技术价值驱动型，这将加速光刻胶等半导体核心材料的国产替代进程。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 1 月 16 日